



关于东莞优邦材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
申请文件的审核中心意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

二〇二六年八月

深圳证券交易所：

贵所《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实函》（审核函〔2026〕010154号，以下简称“《落实函》”）收悉。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为东莞优邦材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“优邦科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，已会同发行人、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、国浩律师（广州）事务所（以下简称“发行人律师”），就需要发行人及各相关中介机构做出书面说明和核查的有关问题逐项落实，并对招股说明书等申请文件进行了相应的修改、补充完善。现将落实函回复如下，请予审核。

说明：

1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》（以下简称“招股说明书”）一致。

2、本落实函回复中的字体代表以下含义：

落实函所列问题	黑体（加粗）
对问题的回复	宋体
对招股说明书等文件的修改、补充	楷体（加粗）

3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

1、关于业绩增长持续性.....	3
------------------	---

1、关于业绩增长持续性

申请文件及问询回复显示：

发行人 2025 年营业收入增速有所放缓，各主营业务的收入、毛利率变动趋势存在一定差异。募投项目拟新增半导体及新能源专用材料产能 51,110.00 吨/年。

请发行人披露：

（1）结合发行人新增产能投产计划、同行业公司产能拓展情况、报告期后新能源及半导体材料相关客户开拓情况等因素，进一步分析产能增加对发行人主要产品市场供需关系、产品价格及销量的影响，是否存在新增产能无法消化的风险。

（2）结合电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备不同业务的经营特点、期后业绩、在手订单、下游需求周期性变化等情况，从定性、定量方面针对性完善招股说明书中对关于各主营业务的经营及财务风险、对第一大客户富士康销售稳定性风险的披露，说明对富士康销售集中的合理性、客户稳定性和业绩持续性，是否存在重大不确定性风险、是否影响持续经营能力等，减少笼统、模版化的表述，避免出现风险对策、竞争对策及类似表达。

请保荐人、申报会计师简要说明核查依据、过程，并发表明确意见。

【回复】

一、发行人披露

（一）结合发行人新增产能投产计划、同行业公司产能拓展情况、报告期后新能源及半导体材料相关客户开拓情况等因素，进一步分析产能增加对发行人主要产品市场供需关系、产品价格及销量的影响，是否存在新增产能无法消化的风险

发行人及行业内主要企业的产能扩张是由下游市场需求驱动的，与下游产业的景气度及技术趋势高度关联，发行人新增产能的爬坡节奏与下游市场需求的放量趋势匹配，同时客户储备亦为新增产能明确了消化路径。发行人及行业内主要企业的产能释放均是基于下游市场扩张和技术革新引发的增量市场需求，而非对

存量市场的重复建设，因此行业新增供给符合下游市场发展需求，不会直接转化为价格及销量压力，产能增加不会对发行人主要产品市场供需关系、产品价格及销量产生重大不利影响。同时受益于下游市场快速发展和国产替代趋势，发行人及行业内主要企业整体保持良性竞争格局，行业整体不存在产能过剩的情形，新增产能无法消化的风险较小。

1、下游市场高景气发展驱动上游扩产

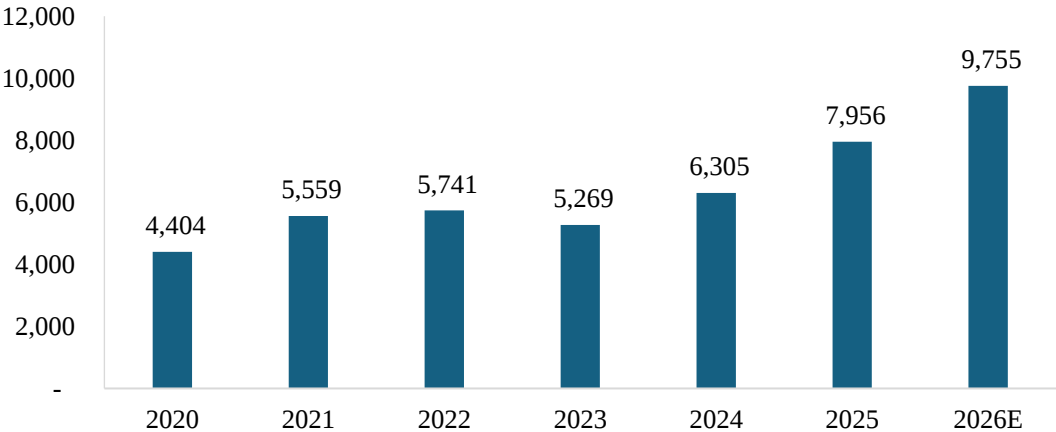
发行人产品在半导体领域的应用场景包括芯片封装、清洗、热管理等，在新能源领域的应用场景包括新能源汽车电子、动力电池、光伏及储能等，对应下游市场均处于高景气发展阶段，下游市场需求驱动上游材料扩产。

(1) 半导体行业

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，全球半导体行业市场规模由 2020 年的 4,404 亿美元增长至 2025 年的 7,956 亿美元，近年增长主要受益于人工智能相关应用以及计算和数据中心基础设施的持续需求，预计 2026 年市场规模将发展至 9,755 亿美元。根据 IDC、摩根士丹利预测数据，因 AI 芯片、自动驾驶等高端应用爆发，2030 年全球半导体市场规模有望达到 1.75 万亿美元，2025-2030 年复合增长率达 15.70%。其中云 AI 半导体 2025 年市场规模已增至 2,350 亿美元，2024-2029 年复合增长率预计达 36%。全球 AI 服务器市场发展、国内半导体封装加速推进国产替代等，为发行人产品销售创造良好市场需求。

2020-2026 年全球半导体行业市场规模及预测情况

单位：亿美元

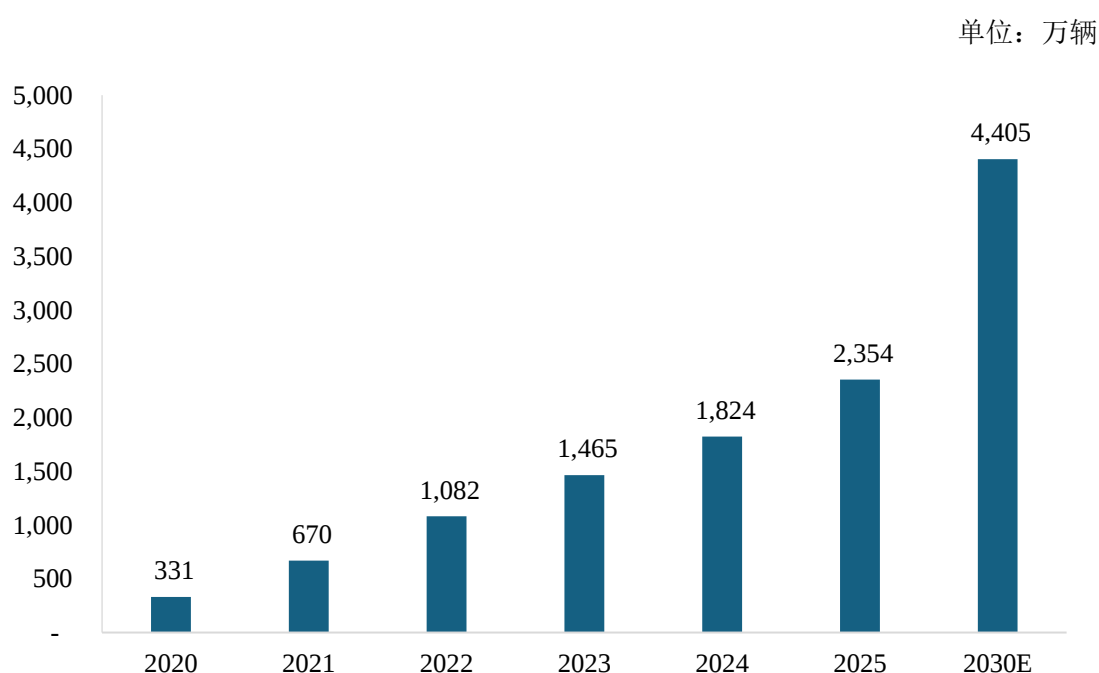


数据来源：WSTS

（2）新能源汽车及动力电池行业

近年来，全球新能源汽车及动力电池市场增长迅速。根据 EVTank 数据，2020 年全球新能源汽车销量为 331 万辆，2025 年增长至 2,354 万辆，2020-2025 年复合增长率达 48.05%。其中，中国市场份额较高，占比达 70.30%。根据 EnergyComment 数据，2025 年全球新能源汽车市场渗透率约为 26%，未来市场渗透率及销量规模仍具有极大提升空间。得益于新能源汽车行业保持高景气的发展态势，为发行人产品销售创造良好市场需求。

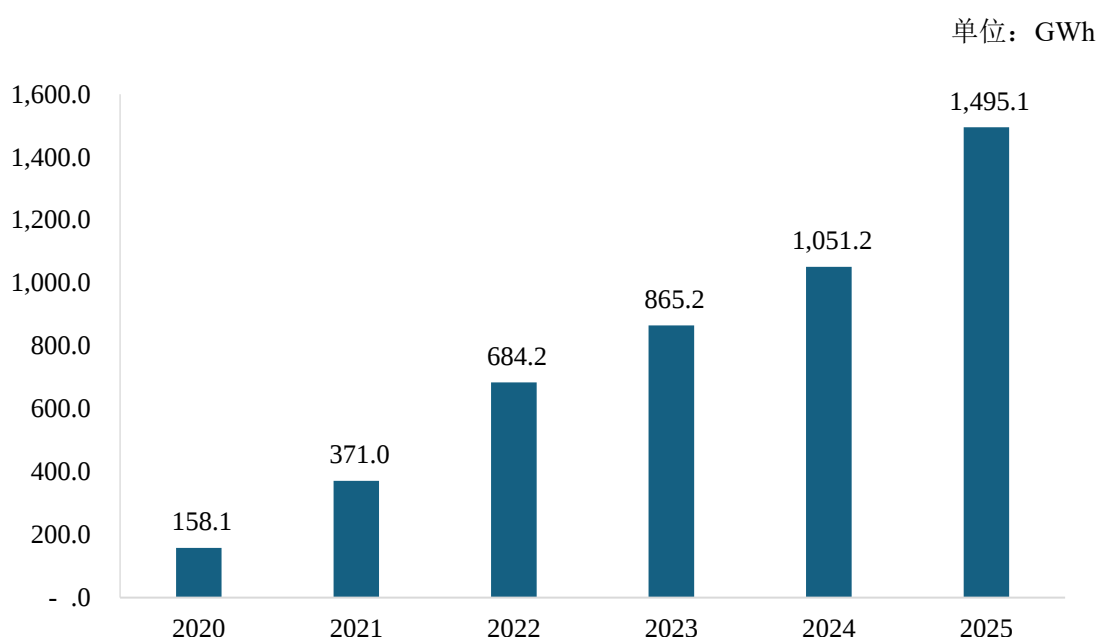
2020-2030 年全球新能源汽车销量



数据来源：EVTank

根据 EVTank 数据，2020 年全球新能源汽车动力电池装机量 158.1GWh，且伴随新能源汽车市场扩张持续攀升，2025 年全球新能源汽车动力电池装机量达到 1,495.1GWh，2020-2025 年复合增长率达 56.73%。根据国际能源署（IEA）发布的报告，全球新能源汽车动力电池装机需求呈持续增长与结构多元化趋势。预计至 2030 年，全球动力电池装机需求量将继续大幅攀升至 3TWh 以上，2025-2030 年复合增长率超过 20%。新能源汽车动力电池装机量增长将带动电子装联材料市场的规模扩张与技术要求提升，为发行人产品销售创造良好市场需求。

2020-2025 年全球新能源汽车动力电池装机量



数据来源：EVTank

综上，未来随着全球半导体及新能源市场持续快速发展，电子装联材料行业将迎来市场规模与产品附加值的双重跃升，为发行人核心业务的持续、稳定、高质量增长奠定了坚实的市场基础。

2、发行人新增产能投产计划产能释放节奏合理

发行人募投项目拟新增半导体及新能源专用材料的产能规模为 51,110.00 吨/年，该募投项目建设期为 2 年，且设定了 4 年的产能爬坡期，假设于 2027 年开始建设，计划于 2029 年陆续投产，至 2032 年基本达产。发行人新建产能释放节奏与下游半导体及新能源市场发展趋势、下游客户认证导入周期及新产线投建周期相吻合。发行人募投项目投产计划、新增产能情况具体如下：

单位：吨

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
新增产能	-	-	-	-	12,778	30,666	43,444	51,110
现有产能	29,181	29,181	29,181	29,181	29,181	29,181	29,181	29,181
总产能	29,181	29,181	29,181	29,181	41,959	59,847	72,625	80,291

2025 年，发行人电子装联材料产品销量为 19,900.56 吨。2032 年达产时，按照 90%的产能利用率测算，若要消化新增产能，对应 2025-2032 年销量复合增长率约为 20%，属于合理、可实现增长率水平。

根据前述研究报告，结合发行人半导体及新能源领域收入结构大致计算，相关下游市场 2025-2030 年预计整体复合增长率亦约为 20%，与发行人为消化募投资项目新增产能所需 20%销量复合增长率相当，本次募投资项目新增产能规模与下游市场增长趋势总体匹配。

3、发行人根据市场需求进行扩产，与同行业公司产能拓展特点一致

近年来，同行业公司扩产情况如下：

公司名称	扩产情况
回天新材	2021 年发行债券募集 3 亿元，投资“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”，一期产能约 1.5 万吨/年已于 2023 年建设完成，二期产能约 3.6 万吨/年预计 2026 年底完成。 2024 年 11 月，以自筹资金约 3,600 万元新建全自动螺杆生产线，新增光伏单组分有机硅密封胶产能约 4.4 万吨/年。 2025 年 12 月，拟投资 9,768 万元新建锂电负极用丁苯乳液粘合剂（SBR）项目，增加产能约 5 万吨/年，建设周期 2 年。 2026 年 7 月，拟投资 12,750 万元建设锂电池电极胶粘剂（PAA）项目，增加产能约 7.2 万吨/年，建设周期 1 年。
德邦科技	2026 年拟投资 23,049.54 万元建设德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目，主要产品为导热膏、导热泥、导热凝胶、导热垫片、相变材料、导电胶等热管理及 EMI 材料，达产后预计产能为 450 吨/年。
德聚技术	2026 年拟投资 4.92 亿元于德聚高端复合功能材料生产项目，项目的建设期为 3.5 年，项目建成后主要面向智能终端、新能源、半导体等领域用电子胶粘剂的生产，项目设计产能为年产电子胶粘剂 5,790.40 吨。 2026 年拟投资 2.11 亿元于德聚北方总部产研一体化项目，项目的建设期为 3.5 年，项目建成后，主要面向智能终端、新能源、半导体等应用领域，从事高性能电子胶粘剂产品生产，项目设计产能为年产电子胶粘剂 1,314.00 吨。
唯特偶	2024 年拟在原计划 17,844.37 万元基础上追加投资 15,893.37 万元（共计 33,737.74 万元），在华东地区新建微电子焊接及辅助材料生产基地，新增产能 3 万吨/年。

注：数据来源为同行业公司公开披露信息。

就扩产方向而言，同行业公司产能扩张呈现出明显的结构化特征，投资导向与高增长赛道的技术演进高度契合，基本聚焦于新能源、半导体、高性能计算等领域。如回天新材对锂电电极胶、光伏密封胶的规模化投入，以及德邦科技对半导体封装及热管理材料的布局等，均是基于下游产业对材料迭代的切实需求，反映了行业从通用领域向高技术壁垒赛道转化的确定性趋势。

就扩产规模而言，发行人与同行业公司较为匹配。回天新材明确的扩产规模超过 15 万吨，约为发行人募投资项目整体扩产规模三倍，德邦科技建设半导体材料产能为 450 吨/年，发行人募投资项目中半导体材料规划产能中底部填充材料等芯片级封装材料约为 100 吨/年，扩产规模与经营规模基本相当。

综上，发行人根据市场需求进行扩产，与同行业公司产能拓展特点一致，行业整体并未出现产能过剩的情形。

4、发行人持续开拓新的优质客户，新增产能已有明确消化路径

报告期内，发行人积极推进半导体及新能源专用材料业务布局，实现半导体及新能源领域销售收入情况如下：

单位：万元

应用领域	2025 年	2024 年	2023 年
新能源	17,528.86	12,678.36	9,874.71
半导体	1,100.77	496.96	434.57
合计	18,629.63	13,175.32	10,309.29
同比变动	41.40%	27.80%	-
占主营业务收入比例	16.56%	12.96%	11.63%

在半导体领域，随着 5G 通讯、物联网、人工智能等新兴技术驱动产业链发展，全球半导体产业持续扩张，2025 年销售额达 7,956 亿美元，国内半导体产业亦实现快速增长，同时国产化进程持续深化，带动对国内电子装联材料企业产品的旺盛需求。发行人通过前瞻性布局，已获得星科金朋、华天科技、甬矽电子、芯德半导体等客户认证并实现量产，成功切入国内产业供应链。发行人战略成效体现为半导体领域销售收入实现快速增长，从 2023 年 434.57 万元增长至 2025 年 1,100.77 万元，年复合增长率达 59.15%。此外，发行人 2026 年新开拓宏茂微电子、成都先进功率半导体等客户，已实现批量交付。

在新能源领域，发行人紧跟产业发展趋势，与台达集团、亿纬锂能、爱士惟集团、麦田能源等客户建立稳定合作，推动新能源领域销售收入从 2023 年 9,874.71 万元增长至 2025 年 17,528.86 万元，年复合增长率达 33.23%。发行人现有客户资源丰富且优质，相关客户需求存在巨大开发空间。譬如亿纬锂能，报告期内发行人对其销售金额从 526.84 万元增长至 2,850.86 万元，年复合增长率达 132%。此外，发行人 2026 年新开拓隆基股份等客户，发行人产品通过该客户认证并于 2026 年开始交易，预计下半年将实现较大规模销售。

综上，发行人具有丰富客户基础，且持续开拓新的优质客户，相关客户需求存在巨大开发空间，为发行人未来新增产能消化奠定坚实基础。

5、产能增加不会对发行人主要产品市场供需关系、产品价格及销量产生重大不利影响，新增产能无法消化的风险较小

电子装联材料产品类型丰富，下游应用领域广泛。由于不同应用场景对电子装联材料性能、工艺适配性、可靠性及成本等方面的要求存在较大差异，尚无单一产品或技术体系能够覆盖全部应用需求，行业内主要企业通常结合自身技术积累、产品体系、客户资源等形成差异化发展路径。因此，发行人与行业内主要企业在产品结构、技术路线、重点应用领域、目标客户等方面存在一定差异，直接竞争和相互替代程度相对有限。

国内中高端电子装联材料市场仍主要由德国汉高、美国陶氏、日本信越、日本千住、德国 ZESTRON、美国 KYZEN 等国际厂商占据主导，国内企业的主要发展方向是提升本土供应能力，逐步实现对国际厂商同类产品的国产替代。发行人与行业内主要企业虽在部分客户、产品或项目中存在一定竞争，但更多系立足各自优势产品和细分应用领域，共同参与对国际厂商的国产化替代。随着下游客户对供应链安全、本土化配套及快速响应能力的重视程度不断提升，以及 AI 服务器、半导体封装、新能源等新兴应用持续发展，国内电子装联材料企业仍具有较大的共同成长空间，行业整体呈现差异化有序竞争的良性发展格局。

综上，由于差异化的发展路径、实现国产替代的共同目标，发行人与行业内主要企业处于相互促进的良性竞争状态，供需关系更多受益于下游市场的持续快速发展，未导致激烈的量价竞争，因此产能增加不会对发行人主要产品市场供需关系、产品价格及销量产生重大不利影响，新增产能无法消化的风险较小。

（二）结合电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备不同业务的经营特点、期后业绩、在手订单、下游需求周期性变化等情况，从定性、定量方面针对性完善招股说明书中关于各主营业务的经营及财务风险、对第一大客户富士康销售稳定性风险的披露，说明对富士康销售集中的合理性、客户稳定性和业绩持续性，是否存在重大不确定性风险、是否影响持续经营能力等，减少笼统、模版化的表述，避免出现风险对策、竞争对策及类似表达

1、电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备不同业务的经营特点、期后业绩、在手订单、下游需求周期性变化

（1）不同业务的经营特点

发行人主营业务包括电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备四大业务板块，为客户提供粘接、焊接、导热、清洗、表面处理等电子装联解决方案，产品最终广泛应用于智能终端、通信、新能源、半导体等领域。发行人不同业务经营特点情况如下：

①服务国家战略性新兴产业，下游市场快速发展

发行人产品主要应用于消费电子、服务器、半导体、通信、工业控制、汽车电子、新能源及储能等领域，下游大多属于国家战略性新兴产业，市场处于快速发展阶段，具有技术迭代快、应用场景不断扩展等特点。

②电子装联材料产品品类多，呈小批量、多批次、滚动采购特征

发行人电子胶粘剂包括有机硅胶、聚氨酯胶、环氧胶、丙烯酸酯胶等，电子焊接材料包括锡膏、锡丝、锡条、锡球、助焊剂等；湿化学品包括清洗剂、切削液、抛光液、保护油墨等，且不同客户、终端产品和工艺路线对产品配方、规格及性能要求存在差异，导致产品品类众多。同时电子装联材料生产和交付周期较短，因此客户主要根据短期生产计划进行小批量、多批次滚动采购，期末在手订单金额通常较小，仅反映客户短期需求情况。

③一线客户进入门槛及供应商转换成本较高

电子装联材料直接影响终端产品的可靠性、稳定性和良品率。进入国内外一线终端品牌及其供应链体系通常需经过资质审核、产品测试、小批量试用、产线验证及量产导入等程序，部分产品还需通过终端品牌和生产厂商双重认证。客户更换供应商后需重新开展测试、认证和产线调试，并承担相应时间成本及潜在质量风险，已完成认证并批量供货的产品通常具有较为稳定的采购基础。

④电子装联材料产品属性及需求影响因素存在差异

电子胶粘剂具有配方定制和应用场景差异较大的特点。电子焊接材料应用领域广，产品价格受到锡、银等原材料价格影响较大；湿化学品与终端产品材料选择、结构设计及加工工艺联系紧密，需求对终端材料和工艺变化较为敏感。

⑤自动化设备业务具有定制化、项目制及实施周期较长的特点

自动化设备业务主要根据客户产线建设、自动化升级、具体工艺需求提供定制化设备，具有非标准化、项目制、单笔订单金额相对较大以及设计、生产、交付、验收周期较长等特点。

⑥电子装联材料与自动化设备业务相互协同、促进

电子装联材料与自动化设备业务具有较强的工艺关联性，一方面电子装联材料在客户产线中的应用能够形成点胶、焊接、检测等配套设备需求，另一方面发行人在设备设计、调试及产线导入过程中能够进一步了解客户对电子装联材料性能和工艺参数的要求，为电子装联材料的开发、验证及批量应用提供支持。电子装联材料与自动化设备业务相互协同、促进，有利于为客户提供综合服务解决方案，增加发行人产品销售类别，扩大销售规模并提高产值贡献。

综上，发行人主营业务贯彻“材料+设备”协同发展战略，其中电子装联材料产品品类多，具有小批量、多批次、滚动采购以及客户进入和转换门槛高等特征，不同产品属性及需求影响因素存在差异；自动化设备具有定制化、项目制及实施周期较长的特点；同时电子装联材料与自动化设备业务具有较强的工艺关联性，相互协同、促进，有利于提升客户综合服务能力。

(2) 下游需求周期性变化

发行人坚持电子装联材料与自动化设备业务协同发展，通过材料、工艺与设备一体化配套提升客户服务能力，两类业务的下游需求驱动因素存在差异。电子装联材料属于电子制造过程中持续使用的材料类产品，需求与终端产品产量、技术迭代和制造工艺变化密切相关，主要覆盖消费电子、AI 服务器及算力基础设施、半导体、通信、工业控制、汽车电子、新能源及储能等领域；自动化设备需求则主要取决于客户资本开支、新增产线建设、工艺升级及设备更新安排，具有较为明显的项目周期性。下游需求周期性变化情况如下：

①人工智能市场爆发式增长，需求持续扩张

AI 服务器、数据中心、高速通信及相关电源、散热和电子组件对焊接可靠性、导热、粘接、封装性能提出更高要求，带动电子装联材料用量及产品性能要求升级，需求持续扩张。发行人服务器领域收入由 2023 年的 9,062.78 万元增长至 2025 年的 18,053.42 万元，复合增长率为 41.14%，服务器领域是发行人电子

装联材料业务增长潜力较大的应用方向。

②消费电子市场规模庞大，整体需求稳定

智能手机、电脑、游戏机、智能穿戴设备等仍是电子装联材料的重要应用领域。消费电子需求受终端产品销量、换机周期和产品迭代等影响，但市场规模庞大，整体需求稳定。国内外一线品牌及其供应链地位相对稳定，AI 手机、AI 电脑、智能穿戴等产品发展将提高终端产品的集成度和性能要求，头部客户将受益于 AI 功能导入及硬件升级，带来高性能电子装联材料的增量需求。

③汽车电子、新能源及储能市场空间大且快速发展，增量需求明显

汽车电子、新能源及储能行业受终端产品销量、扩产节奏和产业投资周期影响，整体市场空间大，且处于快速发展阶段。新能源汽车电动化、智能化以及动力电池、储能系统发展，对结构粘接、导热、灌封和电子焊接材料形成需求。发行人新能源及储能领域收入由 2023 年的 2,560.84 万元增长至 2025 年的 9,304.95 万元，复合增长率为 90.59%，反映该领域需求增长及产品应用扩大。

④半导体市场需求潜力大，国产替代趋势明显

半导体封装、功率器件及相关电子组件对电子装联材料的纯度、可靠性和一致性要求较高，供应商认证周期较长。随着国内半导体产业发展和供应链国产化需求提升，相关领域可形成电子装联材料产品的新增应用，但其需求仍受到半导体行业周期、下游库存及产能利用率变化影响。

⑤自动化设备需求与下游市场发展周期、客户资本开支计划相关

自动化设备需求主要来自消费电子、汽车电子、新能源、半导体等客户新增产线、工艺升级、效率提升和设备更新。下游行业整体处于高景气发展周期，可以带动下游客户产线建设和设备采购需求，但设备采购属于客户资本性支出，通常根据具体项目集中实施，与电子装联材料产品持续滚动采购的模式不同。不同客户产线建设计划、设备更新周期、项目验收进度变化等，均可能导致发行人自动化设备订单和收入在不同期间出现波动。

综上，发行人电子装联材料产品下游应用领域广泛，多领域共同驱动产品需求，其中消费电子市场规模大且整体需求稳定，人工智能、汽车电子、新能源及

储能、半导体等市场处于高景气发展周期；自动化设备需求与下游行业发展周期密切相关，同时亦受不同客户资本开支和具体项目实施周期影响。

(3) 期后业绩及在手订单情况

发行人主营业务期后销售、在手订单情况如下：

单位：万元

产品类别	期后销售			在手订单		
	2026 年 1-6 月		2025 年 1-6 月	2026 年 6 月末		2025 年 6 月末
	金额	变动率	金额	金额	变动率	金额
电子焊接材料	44,598.69	74.05%	25,624.76	2,601.51	69.57%	1,534.16
电子胶粘剂	13,318.70	5.99%	12,566.10	2,572.60	25.50%	2,049.95
湿化学品	4,937.45	-40.58%	8,309.53	331.24	8.22%	306.09
自动化设备	5,278.40	40.10%	3,767.48	7,306.90	0.19%	7,293.19
合计	68,133.24	35.54%	50,267.87	12,812.26	14.57%	11,183.39

注 1：材料类产品期末在手订单金额指已接单尚未发货金额；自动化设备产品期末在手订单金额指已接单尚未验收金额；

注 2：对于材料类产品，下游客户采购具有“小批量、多批次、快速交付”的特点，发行人在客户下单后一般 1-2 周左右即可完成交付，因此期末在手订单规模相对较小。

发行人期后经营情况良好，2026 年上半年主营业务收入 68,133.24 万元，同比增长 35.54%，截至 2026 年 6 月末主营业务在手订单金额 12,812.26 万元，同比增长 14.57%。其中，2026 年上半年湿化学品同比下降，主要受终端产品材质由钛合金向铝合金转换影响，2026 年 7 月湿化学品未经审计收入金额为 1,643.97 万元，环比 2026 年 6 月大幅增长 43.22%，预计下半年湿化学品收入将得到明显改善。

2、从定性、定量方面针对性完善招股说明书中关于各主营业务的经营及财务风险、对第一大客户富士康销售稳定性风险的披露

(1) 经营业绩下滑的风险

发行人已在招股说明书中针对性完善并披露：

“报告期内，公司实现营业收入金额分别为 89,879.23 万元、102,459.82 万元、113,568.72 万元，2024 年、2025 年分别同比增长 14.00%、10.84%，保持持续增长态势，但增速有所放缓。

公司电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备业务在经营模式、成本结构、客户结构、下游需求驱动因素等方面存在差异，各业务面临的经营风险亦有所不同。公司产品主要应用于智能终端、通信、新能源、半导体等领域，下游市场需求受全球宏观经济、国际贸易环境、终端消费需求、产业投资周期、技术迭代进展等因素综合影响。若未来宏观经济增速放缓、国际贸易摩擦加剧，或消费电子、服务器、半导体、新能源及储能等下游行业景气度下降，可能导致客户采购需求减少，并对公司整体经营业绩产生不利影响。

电子胶粘剂业务主要受消费电子终端需求、新能源汽车及储能等下游行业发展、客户及产品结构变化影响。报告期内，公司电子胶粘剂收入基本保持稳定，新能源领域销售占比有所提升。不同应用领域产品在销售规模、价格及盈利水平方面存在差异，若消费电子需求下降、新能源行业增速放缓，或新产品、新客户导入未达预期，电子胶粘剂业务存在业绩下降的风险。

电子焊接材料业务直接材料成本占比超过 90%，且材料成本以锡锭、银等金属原材料为主，产品售价及盈利水平与大宗金属价格具有较强相关性。报告期内，公司电子焊接材料收入持续增长，但若未来锡锭、银等原材料价格大幅波动，而产品售价调整滞后，可能导致毛利率下降；同时，若消费电子、服务器、半导体、通信、新能源及储能等下游需求下降，可能导致销量减少，电子焊接材料业务存在业绩下降的风险。

湿化学品业务收入主要集中于智能终端领域，且对富士康销售集中度较高。智能终端等核心下游行业具有材料创新快、工艺更迭频繁的特征，湿化学品业务需求除受消费电子行业景气度影响外，还受到终端产品材料路线、结构设计、加工工艺变化影响。2025 年湿化学品收入同比大幅下降，主要系富士康代工终端产品材质转换导致金属表面处理剂销量减少所致，终端产品材料变化亦会导致公司产品下游需求出现阶段性波动。公司对富士康的产品导入及供应份额正常，但若未来终端产品发生材质或工艺变化、公司产品无法持续满足客户需求、无法持续保持产品竞争力、无法紧跟工艺演进趋势进行技术研发并及时推出匹配的高附加值产品，亦或富士康采购需求下降、其他客户和应用领域业务拓展不及预期等，湿化学品业务存在业绩继续下降的风险。

自动化设备业务具有定制化、订单驱动和验收周期较长等特点，订单获取

主要受消费电子等下游行业景气度、客户资本开支、新增产线建设、设备更新周期及技术升级节奏影响，各期订单及收入可能存在较大波动。若未来下游市场景气度下降、客户缩减资本性开支、设备更新需求放缓等，公司未能持续获取订单或中标率下降，自动化设备业务存在业绩下降的风险。

综上，若上述不利因素单独或叠加发生，公司部分业务可能出现收入、盈利水平下降，并可能导致公司整体经营业绩增速放缓甚至下滑。”

(2) 客户集中度较高的风险

发行人已在招股说明书中针对性完善并披露：

“报告期内，公司前五大客户相对稳定，合计销售收入占主营业务收入比例分别为 53.86%、49.12%、45.07%，其中第一大客户富士康销售收入占主营业务收入比例超过 20%，公司客户集中度相对较高，存在销售客户集中、对富士康销售占比较高的风险。

报告期内，公司主要客户以国内外一线品牌客户及其供应链企业为主，客户集中度较高符合下游行业特点，公司与主要客户合作关系稳定，主要客户行业地位突出且经营状况良好，交易具有持续性，同时公司持续将产品下游应用领域由智能终端拓宽至新能源、通信、半导体等不同行业，新客户开发和新应用领域业务拓展取得良好进展。但如果未来公司与下游市场主要客户合作出现不利变化、新客户拓展进度不如预期，或公司主要客户因行业竞争加剧、宏观经济波动等原因导致市场份额下降、经营状况出现不利变化，可能导致主要客户减少对公司产品的采购需求、公司与客户合作稳定性和业务持续性受到挑战，从而对公司的业务发展带来不利影响，影响公司持续经营能力。”

(3) 对富士康销售稳定性的风险

发行人已在招股说明书中针对性完善并披露：

“报告期内，富士康为公司第一大客户，公司对富士康销售收入占主营业务收入的比例分别为 34.87%、31.78%、26.55%，销售毛利占公司主营业务毛利的比例分别为 35.46%、29.16%、26.83%，收入及毛利贡献占比较高。公司对富士康销售收入波动具有真实合理原因，非因公司产品竞争力不足导致供应份额下降或者双方合作关系恶化。2025 年公司在对富士康销售减少的情况下，整体收入

仍实现稳步增长，业务发展具备较强韧性，对富士康不存在依赖。

公司自 2008 年起与富士康开展合作，合作业务覆盖电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备，终端应用涉及多个领域。2015 年富士康通过其下属全资投资平台金机虎投资入股公司，目前金机虎投资持有公司 3.44% 比例股份，双方业务合作未因金机虎投资入股而发生重大变化。报告期内，公司对富士康收入、毛利贡献占比下降，但富士康仍为公司第一大客户，若未来富士康及其终端客户采购需求下降、终端产品材料或制造工艺发生重大变化、富士康调整供应商体系，或公司产品不能持续满足其技术、质量及交付要求，导致供应份额下降或合作关系发生重大不利变化，可能导致富士康对公司产品需求减少，进而影响公司对富士康销售的稳定性。”

（4）毛利率波动的风险

发行人已在招股说明书中针对性完善并披露：

“报告期内，公司主营业务毛利率分别为 31.55%、27.43%、27.03%，呈现一定波动。公司电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备业务在成本结构、产品结构、定价方式、客户需求等方面存在差异，各业务毛利率的主要影响因素亦有所不同。

电子胶粘剂业务方面，报告期内毛利率分别为 42.41%、41.09%、37.22%，整体有所下降。该业务毛利率主要受原材料价格及应用领域、产品结构变化影响。2025 年毛利率下降主要系新能源动力电池领域聚氨酯胶销售占比增加所致，该类产品用量较大但毛利率相对较低。若未来新能源动力电池、光伏及储能等相对低毛利率领域销售占比进一步提高，或原材料价格上涨、市场竞争加剧等导致产品价格下降，可能导致电子胶粘剂业务毛利率下降。

电子焊接材料业务方面，报告期内毛利率分别为 21.11%、17.03%、19.23%。该业务直接材料成本占比超过 90%，主要受锡铈、银等大宗金属价格影响。产品售价通常根据原材料价格调整，但部分客户按月度、季度或不定期调价，成本上涨与售价调整之间可能存在一定时间差。若未来锡铈、银等价格短期剧烈波动且未能及时向下游传导，可能导致电子焊接材料业务毛利率下降。

湿化学品业务方面，报告期内毛利率分别为 37.74%、27.46%、28.12%。2024

年毛利率下降，主要系表面处理剂产品降价，以及低毛利率的切削液、保护油墨等产品销售占比提高所致。该业务客户及应用领域相对集中，终端产品材质和加工工艺变化会影响不同产品的需求结构。若未来客户采购价格下降、低毛利率产品占比提高，或终端材质及工艺变化导致高毛利率产品需求下降，可能导致湿化学品业务毛利率下降。

自动化设备业务方面，报告期内毛利率分别为 25.13%、40.01%、40.14%，剔除收购厦门特盈评估增值影响后分别为 30.97%、41.35%、41.22%。该业务以定制化设备为主，不同项目在技术难度、订单规模、竞争程度、成本投入等方面差异较大。若未来低附加值项目占比提高、客户招投标价格下降，或项目调试改造导致成本增加，可能导致自动化设备业务毛利率下降。

综上，若未来产品及应用领域结构变化、原材料价格大幅波动、客户采购价格下降、市场竞争加剧、设备项目结构发生不利变化等，公司各业务毛利率及综合毛利率可能进一步波动或下降，并对盈利能力产生不利影响。”

3、说明对富士康销售集中的合理性、客户稳定性和业绩持续性，是否存在重大不确定性风险、是否影响持续经营能力等

报告期内，富士康主营业务收入和毛利占比情况如下：

项目	收入占比			毛利占比		
	2025 年	2024 年	2023 年	2025 年	2024 年	2023 年
富士康	26.55%	31.78%	34.87%	26.83%	29.16%	35.46%
其他客户	73.45%	68.22%	65.13%	73.17%	70.84%	64.54%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内，发行人对富士康销售集中度相对较高。但结合合作历史、产品导入、供应份额、收入结构、其他客户业务发展等情况，发行人对富士康销售相对集中具有合理性，与富士康合作具备稳定性和可持续性，不存在导致重大不确定性、影响发行人持续经营能力的情形。具体说明如下：

(1) 发行人对富士康销售占比较高与下游行业竞争格局相匹配，发行人主要客户行业地位突出、经营透明度高、经营状况未发生明显不利变化

发行人电子装联材料和配套自动化设备业务下游客户主要包括电子制造服

务商（EMS）和终端品牌厂商，其中大型 EMS 厂商是重要客户群体。全球 EMS 行业市场集中度较高，根据 Manufacturing Market Insider 发布的“2024 年全球 EMS 代工厂 50 强名单”，前十大企业收入占前五十强企业总收入的比例达到 87.6%，其中富士康排名第一，为全球最大的 EMS 厂商。除富士康之外，发行人同时与和硕集团、立讯精密、纬创、伟创力等多家头部 EMS 厂商建立合作关系。因此，发行人对富士康销售金额较大、占比较高，主要系下游产业集中度较高以及富士康自身业务规模较大所致，符合行业经营特征。

全球 EMS 行业市场集中度高，富士康行业地位高，且为中国台湾证券市场上市公司（2317.TW），经营信息可通过公开资料获取，经营透明度高；除富士康之外，发行人主要客户奇宏科技、台达集团、群光电能、明纬电子等均为电子制造行业电源、散热模组等大型制造厂商，发行人主要客户销售集中度较高、对富士康销售占比较高，与下游行业特征、主要客户行业地位相符，不存在下游行业分散而发行人自身客户异常集中的情形。根据主要客户公开信息，以及发行人与主要客户报告期内、期后合作情况，未发现富士康等主要客户行业地位或经营状况发生可能对合作产生重大不利影响的变化，不存在可能导致发行人未来持续经营能力存在重大不确定性的情形。

（2）发行人与富士康等主要客户合作历史较长且合作关系稳定，交易具有可持续性，业务模式符合行业惯例，交易背景真实合理

发行人与富士康自 2008 年开始合作，合作已超过十五年，合作业务覆盖电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备四大业务板块，终端应用涉及手机、电脑、服务器、游戏机、智能穿戴设备等多个领域，交易具有持续性。富士康属于电子制造服务商，而非终端品牌客户，其向发行人采购电子装联材料和自动化设备主要用于终端产品生产制造和产线建设，相关采购需求最终受到终端产品销量、材料选择、结构设计、制造工艺、产能安排等因素影响。发行人与富士康的交易内容与富士康主营业务及 EMS 行业采购模式相符，合作覆盖多个产品类别及终端应用，交易背景真实合理。

除富士康之外，发行人与台达集团自 2009 年、与奇宏科技自 2011 年、与群光电能自 2014 年、与明纬电子自 2013 年开始合作，均具有较长合作历史且合作关系稳定，交易具有可持续性，发行人与主要客户业务模式符合行业惯例，交易

背景真实合理。

(3) 发行人深耕电子装联材料和配套自动化设备业务，具备较强产品和技术实力，持续服务富士康等主要客户新产品开发和导入

发行人与富士康的合作包括电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备四类业务，并覆盖手机、电脑、服务器、游戏机、智能穿戴设备等多个终端应用。不同终端产品在材料体系、性能指标和加工工艺等方面存在差异，相关产品需根据客户需求完成配方开发、性能测试、工艺适配及产线验证后方可批量供货。发行人围绕富士康不同应用场景和生产环节持续开发、导入多类产品，具备较为完整的产品体系以及较强的配方开发、工艺适配和量产供应能力。

发行人与富士康、台达集团等主要客户的合作并非依赖单一产品或单一终端项目，而是以多类电子装联材料和自动化设备覆盖不同终端应用和生产工艺环节。发行人相关产品及技术路线能够根据终端产品材料选择、结构设计、制造工艺、性能要求变化等进行开发和适配。报告期内，发行人持续参与主要客户新产品开发和导入，相关合作具有产品和技术基础。

(4) 富士康等主要客户对供应商的认证门槛和转换成本较高，有利于维持长期合作，发行人不存在对主要客户供应份额或产品竞争力明显下降情形

进入国内外一线终端品牌客户及其供应链 EMS 厂商、专业模组制造商等供应体系通常需经过资质审核、产品认证、小批量试用及产线导入等环节，部分产品还需终端品牌与生产厂商双重认证，认证周期通常可达 6-18 个月。客户更换供应商后需重新承担认证、测试、产线调试及潜在质量风险，因此现有供应关系具有较强持续性。

报告期内及期后，发行人在富士康、台达集团、奇宏科技等主要客户的产品导入和供应份额保持正常，未出现因产品竞争力下降、认证资格丧失或供应商替换导致合作发生重大不利变化的情形。

(5) 发行人具备独立面向市场获取业务的能力，富士康入股未导致发行人业务获取和经营缺乏独立性，双方交易按照市场化原则定价，具有公允性

2015 年富士康通过下属投资平台金机虎投资入股发行人，目前金机虎投资持有发行人 3.44% 比例股份。发行人与富士康业务合作始于 2008 年，早于金机

虎投资入股时间，且双方业务合作未因金机虎投资入股而发生重大变化。

发行人具备独立面向市场获取业务的能力，依靠产品开发、客户认证、量产供应及服务能力等获取富士康及其他客户业务，富士康入股未导致发行人业务获取和经营缺乏独立性，双方交易按照市场化原则定价，具有公允性。

(6) 发行人产品系应用于国家政策支持发展领域，相关行业市场规模大且处于发展阶段，发行人持续推进客户及下游应用领域拓展并取得良好进展

发行人产品下游应用领域包括消费电子、服务器、半导体、通信、新能源及储能、汽车电子等领域，基本属于国家政策支持发展的战略新兴领域，且相关行业市场规模大、新兴行业市场处于快速发展阶段，为发行人持续推进产品销售和客户拓展创造良好市场发展和需求基础。

报告期内，发行人对富士康销售收入、毛利总体保持稳定。在持续深化与富士康合作、推进共同开发和新品导入的同时，发行人主动推进客户及下游应用领域拓展，一方面通过现有集团客户内部横向开发，增加合作主体及产品种类；另一方面围绕服务器、半导体、通信、新能源及储能、汽车电子等领域开展产品开发、客户认证及新客户导入，逐步形成多元化的客户和应用领域结构。除富士康外，发行人已与台达集团、群光电能、奇宏科技、立讯精密、亿纬锂能等客户形成持续合作，产品应用领域亦由消费电子不断延伸至服务器、半导体、通信、新能源及储能、汽车电子等领域。发行人通过持续开发新产品、拓展现有客户内部合作、导入新客户和新应用领域，推动客户及收入结构趋于多元。

(7) 发行人期后经营表现良好，持续经营基础进一步夯实

2026 年上半年，发行人营业收入同比增长 36.65%，归母净利润同比增长 28.53%，扣非后归母净利润同比增长 20.04%，在对富士康销售占比保持下降的同时，经营业绩继续增长，体现了发行人业务发展的独立性和持续性。

综上，发行人对富士康销售占比较高主要系全球 EMS 行业集中度相对较高所致，与下游行业竞争格局相匹配，具有合理性；富士康行业地位高、经营透明度高、经营状况未发生明显不利变化；发行人与富士康合作历史悠久、合作基础稳固、合作领域广泛，发行人具备较强产品实力，持续服务富士康新产品开发和导入，认证及转换壁垒较高，双方合作关系具备稳定性和可持续性；发行人具备

独立面向市场获取业务的能力，富士康入股未导致发行人业务获取及经营缺乏独立性，双方交易定价公允；同时发行人客户及应用领域持续拓展，在对富士康收入、毛利规模保持稳定的情况下，其他客户业务增长良好，整体经营业绩持续提升。因此，发行人对富士康销售相对集中具有合理性，与富士康合作具备稳定性和可持续性，不存在导致重大不确定性、影响发行人持续经营能力的情形。

二、中介机构核查情况

请保荐人、申报会计师简要说明核查依据、过程，并发表明确意见。

（一）核查情况

1、查阅发行人募投项目可行性研究报告，了解募投项目拟生产产品的产能规划、投产规划情况，了解产品优势、客户需求、市场前景。

2、查阅行业研究报告，了解行业市场空间、技术发展趋势、下游市场需求变动等情况；查阅同行业公司公开资料，了解其产能拓展情况。

3、访谈发行人管理层，了解发行人主要客户在手订单及执行情况、期后业绩等情况、新客户开拓情况，了解产能增加对发行人产品市场供需关系、产品价格及销量的影响，新增产能的消化风险。

4、访谈发行人管理层，查阅发行人期后财务报表、在手订单统计，查阅行业研究报告，了解电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备业务经营特点、期后业绩、在手订单、下游需求周期性变化情况。

5、复核发行人更新后的招股说明书风险因素章节，确认发行人是否已完善不同业务相关风险提示。

6、访谈发行人管理层，了解发行人对富士康销售集中度较高的原因和合理性，了解发行人与富士康合作的稳定性和持续性。

（二）核查意见

1、发行人新增产能投产计划产能释放节奏合理，与下游市场需求放量趋势匹配；同行业公司存在产能拓展情况且特点一致；发行人持续开拓客户，新增产能已有明确消化路径；产能增加不会对发行人主要产品市场供需关系、产品价格及销量产生重大不利影响，新增产能无法消化的风险较小。

2、发行人主营业务贯彻“材料+设备”协同发展战略，电子装联材料产品品类多，具有小批量、多批次、滚动采购以及客户进入和转换门槛高等特征，不同产品属性及需求影响因素存在差异，自动化设备具有定制化、项目制、实施周期较长的特点，电子装联材料与自动化设备业务具有较强的工艺关联性，相互协同和促进；发行人已在招股说明书中完善不同业务相关风险提示；发行人对富士康销售相对集中具有合理性，与富士康合作具备稳定性和可持续性，不存在导致重大不确定性、影响发行人持续经营能力的情形。

（本页无正文，为东莞优邦材料科技股份有限公司《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实函的回复》之签字盖章页）

发行人董事长：

郑建中
郑建中

东莞优邦材料科技股份有限公司
2026 年 8 月 13 日

发行人法定代表人声明

本人已认真阅读《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实函的回复》全部内容，确认回复的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

发行人法定代表人：

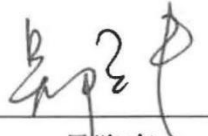

郑建中

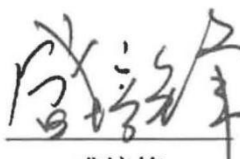
东莞优邦材料科技股份有限公司

2026 年 8 月 13 日

（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实函的回复》之签字盖章页）

保荐代表人：


吴隆泰


盛培锋

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026 年 8 月 13 日

保荐人法定代表人声明

本人已认真阅读《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实函的回复》的全部内容，了解回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核问询函回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人法定代表人：


王明希

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026 年 8 月 13 日

（本页无正文，为《关于东莞优邦材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》之盖章签字页）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国•上海

2026年8月13日